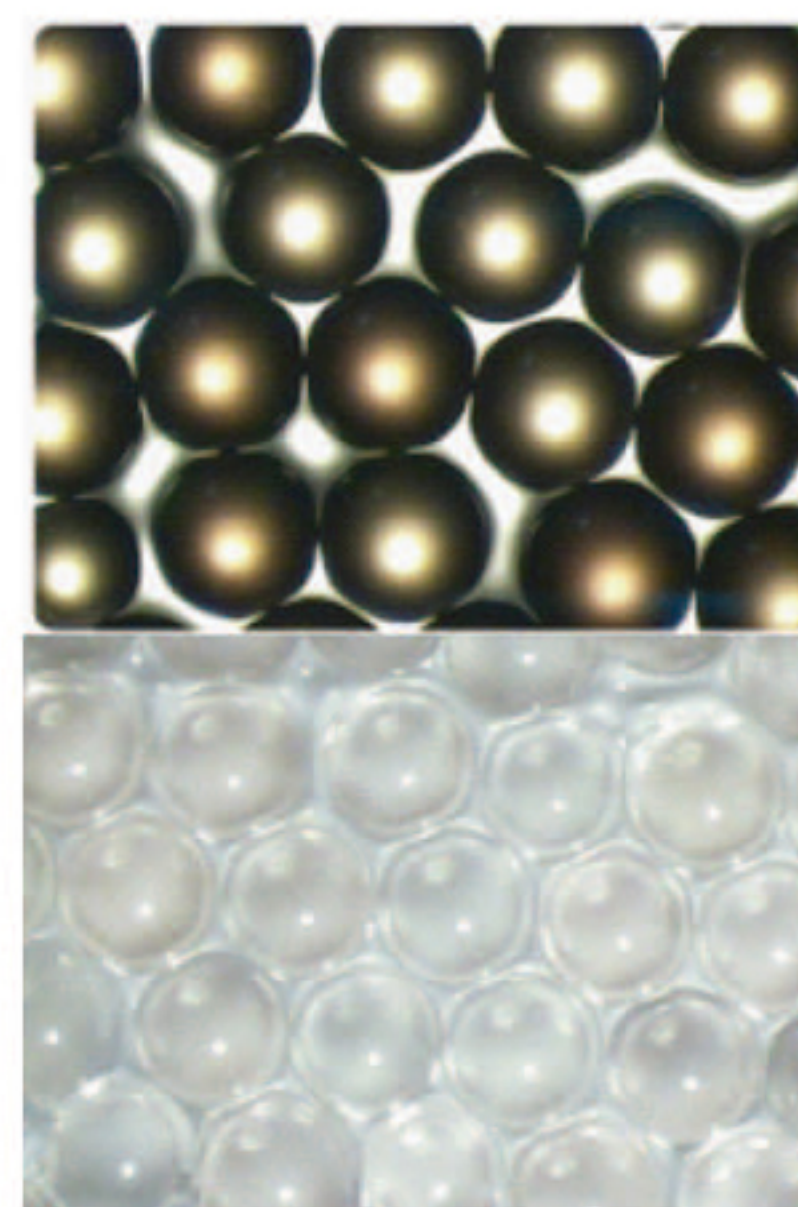


RHSP半导体级精炼树脂

H.N.K RHSP 半导体级精炼树脂是一种专为水质要求超过18MΩ以上之超纯水系统所设计，其具有以下特性：

- 极佳的物理及化学稳定性。
- 较高的交换容量及交换速率（H⁺ Form ≥ 2.0 eq/L、OH⁻ Form ≥ 1.1 eq/L）
- 较低TOC及Silica的泄漏量。
- 较高的通水流量（50 BV/hr），凝胶型均球颗粒。
- 基于以上特性，使得RHSP可在消耗最少的清洗水下，达到超纯水的水质要求。

技术参数表		
特性	阳离子H ⁺	阴离子OH ⁻
基质	聚苯乙烯二乙烯基苯共聚物	
官能基	磺酸	季胺
形态	深琥珀色透明的珠子	黄色透明的珠子
总交换容量eq/L	≥2.0	≥1.1
含水量 %	44~51	54~60
平均粒径 μm	600~700	580~680
重量 g/L	710	
标准包装 L/桶	50	



操作条件建议	
进水温度	15~25℃ (60~77°F)
最大操作温度	60℃ (140°F)
最小床深	900mm (3feet)
供水流量	30BV/hr~50BV/hr



RHSP树脂适用于光电、封测、太阳能及LED...以下等相关电子产业，特别是水质要求在18MΩ以上之超纯水系统。（本树脂请勿使用于食品或饮用水相关制程）